



## Tagesordnung

- Thema: **67. Treffen des Industrie-Arbeitskreises** Rechtskonformes Umweltmanagement in der Elektronikindustrie: Umsetzung von RoHS, REACH, ErP, WEEE und weiteren Umwelanforderungen
- Datum: **Donnerstag, den 13. Juni 2024, 10:00 Uhr**
- Ort: **Fraunhofer IZM**  
Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 17, Raum 60a/b, 13355 Berlin
- Teilnehmer: Arbeitskreismitglieder, Referenten

## Agenda

ab 09:30 Uhr

Anmeldung und Kaffee

10:00 Uhr

### **Neues aus der Gesetzgebung**

Nils Nissen, Fraunhofer IZM

10:30 Uhr

### **Relevanz des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) für die Elektronikbranche**

Robert Kaiser, tacto

11:10 Uhr

### **Chancen und Herausforderungen der Product Carbon Footprint Berechnung im Maschinen- und Anlagenbau**

Hannah Lena Harlos, VDMA

11:50 Uhr

### **PFAS: Anwendung, technische Funktionen und Substitutionsmöglichkeiten in der Industrie**

Christian Kühne, THINKTANK Industrielle Ressourcenstrategien

12:30 Uhr

Mittagessen

13:30 Uhr

### **Ganzheitliche Betrachtung der erweiterten Herstellerverantwortung in Management, Prozessen, Daten & IT: Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze**

Patrick Schneider, WEE Enable IT Consulting

14:10 Uhr

**Überblick Anforderungen und aktuelle Entwicklungen im Bereich Flammenschutz von Kunststoffen für Elektro- und Elektronikanwendungen**

Elke Metzsch-Zilligen, Michael Großhauser, Fraunhofer LBF

14:50 Uhr

Kaffeepause

15:10 Uhr

**Management von Kunststoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten und Auswirkungen von bromierten Flammenschutzmitteln**

Arthur Haarman, dss+

15:50 Uhr

**Erfahrungen mit dem Reparaturbonus in Thüringen**

Erik Poppe, Fraunhofer IZM

16:30 Uhr

**Abschließende Diskussion**

16:45 Uhr

Ende der Veranstaltung